

# Cutting Edge

第68期 事業のご報告

平成18年4月1日～平成19年3月31日

証券コード：6146



**DISCO**

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



## DISCOの成長を 見守ってください。

社長インタビュー DISCO VISIONの実現に向けて  
DISCO Technology DFL7160 「高度にKiru」技術の展開  
DISCO Story ④ “Xプロジェクト”を実行せよ



「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術によって  
遠い科学を身近な快適につなぐ」  
3つのコア技術を深めることで、  
ディスコは産業と人の暮らしに貢献しています。

## 高度なKiru・Kezuru・Migaku技術とは...

「切る」「削る」「磨く」は、古代から脈々と培われてきた人類に欠かせない技術です。  
ディスコはこの普遍的な技術を深化させ、またこの技術領域における世界のオンリーワンでありたいと考えています。  
[Kiru][Kezuru][Migaku]とローマ字表記しているのは、ディスコの技術が世界標準となり、  
日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという思いが込められているからです。

## 遠い科学を身近な快適につなぐとは...

科学は日々進歩しています。しかしどれほど進歩しようともそれだけでは社会の進歩や人類の幸せに役立つとは限りません。  
ディスコの技術によってそんな遠い科学を人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたいという思いを込めています。

## ディスコが追い求める成長とは...

企業の軸として据えた社会的使命に則り、あらゆるステークホルダーとの価値交換を通じ、  
長期にわたる成長ストーリーを発信し、また実現していく。ディスコはそんな企業でありたいと考えています。

### Contents

- ② 株主の皆様へ
- ③ 社長インタビュー
- ④ DISCO News
- ⑤ DISCO Business
- ⑥ DISCO Technology
- ⑦ DISCO Values
- ⑧ 連結財務諸表
- ⑨ 株主アンケート結果
- ⑩ 会社情報および株式の状況
- ⑪ DISCO Story...
- ⑫ ⑬ ⑭

# To Our Shareholders

株主の皆様へ

## DISCO VISION実現のため 一体となって進んでまいります。

株主の皆様には、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。当社は2007年5月5日に創業70周年を迎えました。

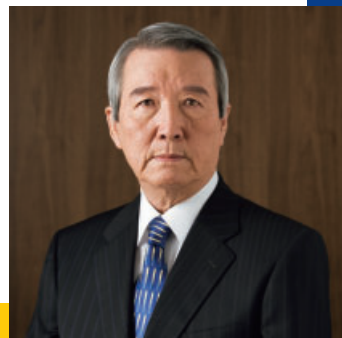
これもひとえに株主の皆様をはじめ、関係各位のご支援の賜物であり、厚く御礼申し上げます。

### 当期の経営環境と業績

2007年3月期は、安定的な世界経済の拡大に支えられ、デジタル機器を中心に半導体および電子部品の需要は堅調に推移し、半導体メモリーメーカーを中心として、積極的に設備投資が行われました。当社の精密加工装置は、ダイサ、グラインダともに高水準での生産・出荷が行われました。特にSiP向けの薄化用グラインダは、NAND型フラッシュメモリーの大増産に伴い非常に好調に推移しました。また、精密加工ツールも生産・出荷が過去最高を記録しています。これらにより、売上高は過去最高の861億60百万円(前期比25.1%増)、経常利益は196億67百万円(同36.5%増)となり、2001年3月期に次ぐ業績を達成することができました。

### VISION実現への取り組み

2010年のDISCO VISIONの実現に向けた取り組みですが、事業像、経済像、組織像などそれぞれの目標に対しマイルストーン(道標)を設定し、確実なトラッキングを実施しています。現在、海外拠点も含め従業員一人ひとりの能力を「進化」させる取り組みに力を入れ、全社が一体となって目標達成へ向かっております。



2007年度も、BRICs(\*1)・VISTA(\*2)といった新興市場において、携帯電話などの普及が見込まれていることに加え、2008年に開催される北京オリンピックも半導体需要の盛り上がりへ寄与するものと期待されます。そのような環境の中で、当社は「高度なKiru・Kezuru・Migaku」技術のさらなる深化に向けて、先端技術開発に努めてまいります。

\*1 BRICs ブラジル、ロシア、インド、中国の頭文字を合わせた4カ国の総称。

\*2 VISTA ベトナム、インドネシア、南アフリカ、トルコ、アルゼンチンの頭文字を合わせた5カ国の総称。

### 配当について

株主様への利益還元につきましては、前期より採用しております連結配当性向20%に基づく配当に加え、創業70周年を記念して記念配当10円を実施させていただきたいと存じます。これにより年間配当は75円(中間配当30円、期末配当35円、創業70周年記念配当10円)となります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

2007年6月

代表取締役社長 溝呂木 齊

# Interview with the President

社長インタビュー

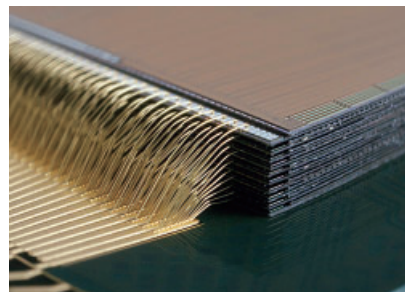
Q

**最近の経営環境の変化をどのように捉えていますか？**

A

**世界的なデジタル技術の普及と薄化技術ニーズの高まりにより、ディスクの活躍できる技術領域が急速に拡大しています。**

半導体は、携帯音楽プレーヤーやデジタルカメラなどの記録メディアとして使われ、普及も進んでおり、人々の生活がより便利で快適になっています。今後は、IC搭載の電子マネーやパスポートが一般化してきますし、自動車への搭載、さらにLED（発光ダイオード）などの普及が加速してくるだろうと思います。一方で技術的には、微細化技術に限界が見られることから、チップを何枚も重ねてひとつのパッケージとするSiP技術がますます必要になってきました。当社は、このSiP技術に不可欠である薄化に伴う様々な技術的な課題を克服するための開発に注力していますが、こういった技術が今後も大きなビジネスチャンスにつながると考えています。



エルピーダメモリ株式会社様で提供

Q

**DISCO VISIONの実現に不可欠な要素は何でしょうか？**

A

**良質な企業文化をさらに育てていくことで、ビジョンの実現を目指します。**

DISCO VISIONは、1990年代後半に2010年を見据えて、ミッションを達成するための道標として策定したものです。VISIONは売上や利益の目標を示すのではなく、2010年にあるべき姿を様々な角度から設定することによって、企業としての成長する方向性を示しています。このVISIONを実現するためには、企業文化のあり方が非常に大切になります。企業文化は10年、15年、20年というスパンの間に地道に積み上げて育てていく必要があります。そのため、毎年、DISCO VALUESの理解を新入社員のみならず管理者、海外の現地社員にも徹底的に促しています。このように、DISCO VALUESを核にした企業文化の中で従業員が高い意識を持ち、的確なアイデア、自発的な活動を展開できるよう促すことが経営の大切な仕事だと考えています。

Q

## ディスコの技術の優位性は何でしょうか？

A

### Kiru・Kezuru・Migaku領域の深耕が成長への原動力です。

ディスコは、事業領域をKiru・Kezuru・Migaku (KKM) に絞っています。この領域に集中して経営資源を投入し、徹底的にこの技術の可能性を広げるべく研究開発を行っています。現在、従業員の44%が技術開発に従事しており、2008年にはR&D新棟が完成し、開発力のさらなる拡充が図られる予定です。また、KKMのニーズを掘り起こす徹底した市場調査や技術取得のためのM&Aなどを行うことで、KKM技術を深耕していきたいと考えています。



Q

## 株主還元にはどのようなお考えをお持ちですか？

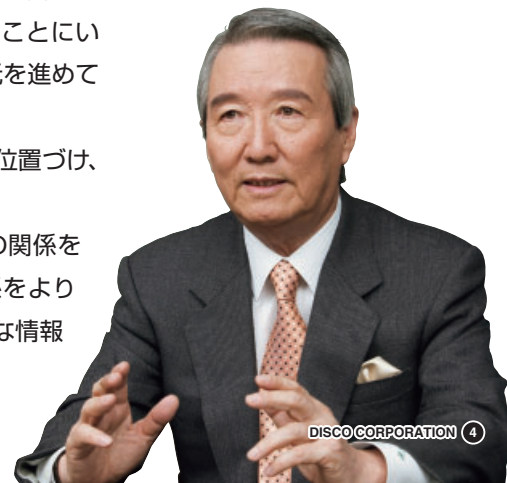
A

### 株主の皆様と、より強固な価値交換を推進してまいります。

当社は、第67期(2005年度)より、株主の皆様への配当を業績連動型に改め、配当性向20%を目標に据えました。また、現預金残高が企業経営に必要な資金を上回った場合には、超過資金の一部を配当に上乘せすることにいたしました。こうした施策を今後も継続し、株主の皆様への利益還元を進めてまいります。

ディスコは株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけ、今後も企業価値の向上に全力で取り組んでまいります。

私は、ディスコと株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの関係を「価値交換」と考えています。価値交換とは、いわばWin-Winの関係をより強固なものにしていくことを意味します。その実現のために、迅速な情報開示をはじめとする積極的なIR活動を展開してまいります。



今期のDISCOを振り返ります。

## SEMICON JAPAN 2006

昨年、30周年を迎えたセミコンジャパン（主催：半導体製造装置メーカーの業界団体SEMI）。好調な半導体市場を反映して、会場の千葉県幕張メッセは例年以上に大賑わいとなりました。当社の今回のテーマは「高度なKiru・Kezuru・MigakuのSHINKA（SHIN＝深・進・新）。SHINKAしたディスコの製品・技術を来場者が理解できるように展示を工夫し

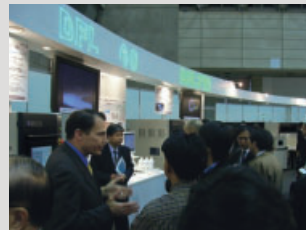
ました。特に、最新のレーザ装置DFL7160は実機を3台設置、レーザビームによる照明も用意するなどディスコの技術をアピールする機会となりました。

【3つのSHINの意味】

「深」＝成熟しつつある技術のさらなる深耕

「進」＝技術等の進化

「新」＝新しい技術の開拓



## 米インテル社より SCQI賞を7年連続受賞

当社は、インテル コーポレーション（本社：米国カリフォルニア州サンタクララ）より、2006年度サプライヤー・コンテニューアス・クオリティー・インブルーメント（SCQI）賞を受賞いたしました。この賞は、インテルの成功に貢献した製品とサービスの供給において、卓越した品質と成績を達成した企業に贈られるものです。ディスコの高精度なシングレーションシステム、ダイシングソー、ポリッシャおよびグラインダの供給努力や、品質、技術、インテルの優先課題への対応が評価され、7年連続の受賞となりました。



## 自衛消防隊操法大会で 男女共に優勝

ディスコはCSR（企業の社会的責任）の観点から、EHS（環境と健康、安全への配慮）に積極的に取り組んでいます。活動の一環として、昨年9月に東京都大森地区の企業を対象とした消火技能・ポンプ取扱いの迅速性や正確性を競う大会に出場しました（大森消防署主催）。社員合計6名が2か月間練習を積んで大会にのぞんだ結果、男女共に優勝することができました。大会出場が地域における役割を果たすこと、社員の安全（防災）意識の向上につながると考えています。



## ディスコ最大の強み アプリケーション(応用)技術

半導体や電子部品の回路を作り込む土台(ウェーハ)には、セラミック、フェライト、シリコンなど様々な素材が用いられます。そうした素材を加工する際、最良の加工結果を得るための条件を提供する技術がディスコの誇るアプリケーション技術です。

15,000種類の精密加工ツールと50機種の精密加工装置。このふたつの組合せは無限にあり、最良の加工条件(ベストソリューション)をお客様が選定するのは容易ではありません。ブレードやホイールの回転速度、加工中の水の流量など、いくつものパラメータが複雑に関わるからです。ディスコは「Kiru・Kezuru・Migaku」に関するお客様の相談、ニーズにお応えしてきた歴史の中で、このベストソリューションを導き出すノウハウを蓄積してきました。業界において装置とツ

ル両方を製造する世界で唯一のメーカーとして、ディスコはアプリケーション技術を最大の強みにCS(顧客満足)を図り、優位性を堅持しています。

このアプリケーション技術の開発を担っているのが、本社をはじめ、世界各国にある「アプリケーションラボ」です。ここには新しい素材、プロセスに関して、年間2,500件以上もの案件がお客様から持ち込まれ、約90名の専任エンジニアがあらゆる問題解決に力を注いでいます。このように徹底的にお客様満足を目指す一方で、その解決の過程が新技術や製品の開発につながることもあります。「薄化技術」「レーザ技術」などのアプリケーション技術も、このラボから誕生して、世界の先端技術の開発に貢献しています。



# DISCO Technology

## DFL7160

### 「高度にKiru」技術の展開

半導体製造プロセスは、ウェーハの大口径化・回路の微細化とともに進化してきました。これは同時に、半導体に用いられる素材の複雑化および多様化の歴史でもあります。

当社では、進化し続ける半導体製造プロセスに対応するため、従来の精密ダイヤモンド砥石に加えてレーザー光を用いた精密切断技術をラインアップしています。

当社のDFL7160は、砥石では加工が困難であった素材をレーザー光によって高速かつ高品質で加工、さらに、洗浄から乾燥まで一貫して行うことのできる300mmウェーハ対応の精密切断装置です。

近年、高機能デバイスへの使用が拡大しているウェーハ上のLow-k膜(\*1)や銅などの金属配線、薄仕上げシリコンウェーハに用いられるDAF(\*2)、青色LED製造に用いられるサブファイヤ基板などは、素材の性質上非常にもろいため、砥石に

よるダイシングでは、品質上問題がありました。DFL7160は、それらの素材の表面のグルーブ(溝付け)や、完全切断などといった加工が可能です。

砥石を用いた切断技術およびその市場はこれからも伸びていくことが確実ですが、レーザーによる切断技術をラインアップし、高度化する顧客ニーズに対応することで、当社は顧客の生産性・品質に大きく貢献しています。

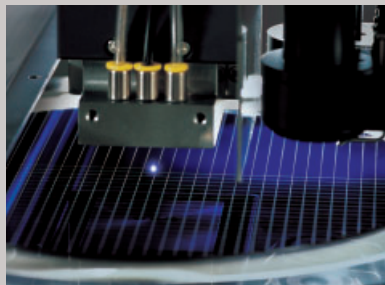
\*1 Low-k膜

低誘電体層間絶縁膜。チップの微細化に伴い、半導体回路配線がより隣接するようになってきていることから起こる配線間信号干渉を回避するために使用される材料。

\*2 DAF

ダイアタッチフィルム(Die Attach Film)。半導体チップを実装・積層化するために用いられる粘着フィルム。

DFL7160

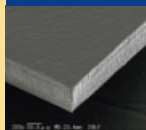


DFL7160内でレーザーによって加工中

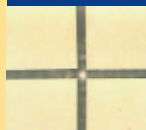
### ◎レーザーアプリケーションの拡大

通常のダイシングソーでは難しかった様々な素材の加工が可能となりました。

GaAsウェーハ



サブファイヤ



DAF(Die Attach Film)



薄仕上げシリコンウェーハ



## 価値交換性の向上を目指して 様々なステークホルダーと共に成長を

企業市民や企業の社会的責任（CSR）など、近年、企業活動において社会の一員としての責任を果たす活動の重要性が高まっています。

また、企業会計用語にgoing concernという言葉もあります。「継続企業の原則」と呼ばれるものですが、「企業は継続する社会的責任がある」という意味もあります。

このように、現在「企業が社会の中でその責任を果たしつつ、存在を継続すること」が強く社会から要請されているのです。

では、企業が社会の中でその存在を継続し、その価値を高めていくための要件は何でしょうか？ 売上？ 利益？ 知名度？ カリスマ経営者？ きっとひとつひとつどれもが要件となりうると思われれます。

ディスコでは、企業としての価値を高めるためには「価値交換性の向上」が必要であると考えています。価値交換性の向上とは、「買い手よし、世間よし、売り手よし」という近江商人の三方良しの精神と同義です。

例えば、お客様にとってディスコは、製品を販売するだけでなく最適な加工結果やサービスを提供することで、信頼できるパートナーになる。また、ディスコで働く人々にやりがいや自己実現の場を提供することで、よりよい企業活動を実現していく。このようなつながりが深まっていくことが「価値交換性の向上」であり、ディスコの考える成長です。



企業は、顧客・サプライヤー・株主・従業員・地域社会など、様々なステークホルダーとの関係に支えられ存在しています。その関係を良好に維持することなくしては、企業としての発展を望むことはできません。

短期的な利益追求にとらわれることなく、長期的なステークホルダーとの価値交換を深めていくことや、ディスコは将来のあるべき姿へと進んでいきます。

# Financial Statements

## 連結財務諸表(要旨)

### 連結貸借対照表

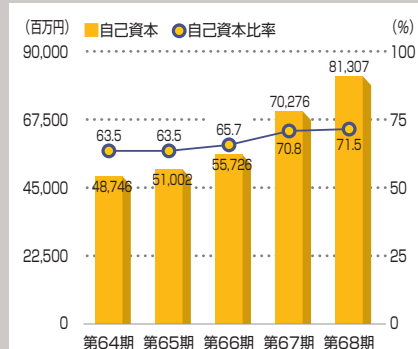
(単位:百万円)

科目	第68期 平成19年 3月31日現在	第67期 平成18年 3月31日現在
<b>資産の部</b>		
流動資産	75,799	64,279
固定資産	37,991	35,039
有形固定資産	33,603	29,057
無形固定資産	925	758
投資その他の資産	3,462	5,223
<b>資産合計</b>	<b>113,791</b>	<b>99,318</b>

(単位:百万円)

科目	第68期 平成19年 3月31日現在	第67期 平成18年 3月31日現在
<b>負債の部</b>		
流動負債	28,819	25,493
固定負債	3,148	3,123
<b>負債合計</b>	<b>31,967</b>	<b>28,617</b>
<b>廃止</b> 少数株主持分	-	<b>424</b>
<b>廃止</b> <b>資本の部</b>		
資本金	-	13,412
資本剰余金	-	14,494
利益剰余金	-	41,899
その他有価証券評価差額金	-	303
為替換算調整勘定	-	205
自己株式	-	△39
<b>資本合計</b>	-	<b>70,276</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	-	<b>99,318</b>
<b>新設</b> <b>純資産の部</b>		
株主資本	80,551	-
資本金	14,485	-
資本剰余金	15,567	-
利益剰余金	50,553	-
自己株式	△53	-
評価・換算差額等	755	-
その他有価証券評価差額金	59	-
為替換算調整勘定	696	-
新株予約権	65	-
少数株主持分	450	-
<b>純資産合計</b>	<b>81,823</b>	-
<b>負債、純資産合計</b>	<b>113,791</b>	-

### 自己資本・自己資本比率



資産は前年同期比144億72百万円増加しました。また、売上の好調に伴う利益剰余金の増加などにより、自己資本は前年同期比110億30百万円増加、自己資本比率は70.8%から71.5%と微増しました。

2006年5月1日施行の会社法により、「少数株主持分」「資本の部」が廃止され、「純資産の部」が新設されました。

これは貸借対照表上、資産性を持つものを「資産の部」、負債性を持つものを「負債の部」に記載し、それらに該当しないものを資産と負債の差額として「純資産の部」に記載するものです。

これにより、会社の支払能力などの財政状態をより適切に表示することが可能となります。

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

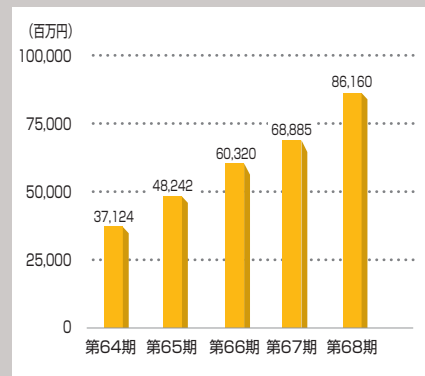
科目	第68期	第67期
	自平成18年4月1日 至平成19年3月31日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
売上高	86,160	68,885
売上原価	42,106	32,734
販売費及び一般管理費	24,529	22,201
<b>営業利益</b>	<b>19,524</b>	<b>13,949</b>
営業外収益	497	590
営業外費用	354	129
<b>経常利益</b>	<b>19,667</b>	<b>14,410</b>
特別利益	309	16
特別損失	2,261	1,041
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>17,715</b>	<b>13,385</b>
法人税、住民税及び事業税	7,450	5,077
法人税等調整額	△720	18
少数株主利益	49	58
<b>当期純利益</b>	<b>10,936</b>	<b>8,230</b>

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

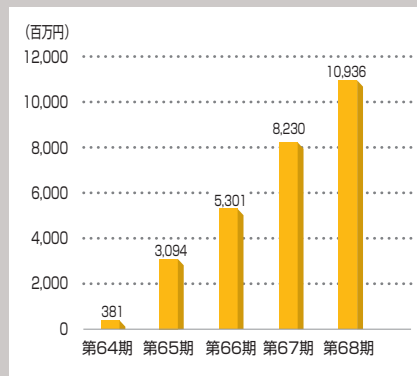
科目	第68期	第67期
	自平成18年4月1日 至平成19年3月31日	自平成17年4月1日 至平成18年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,194	12,322
投資活動によるキャッシュ・フロー	△8,952	△4,409
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,428	△3,031
現金及び現金同等物に係る換算差額	227	230
現金及び現金同等物の増加額	2,041	5,111
現金及び現金同等物の期首残高	22,003	16,891
現金及び現金同等物の期末残高	24,045	22,003

### 売上高



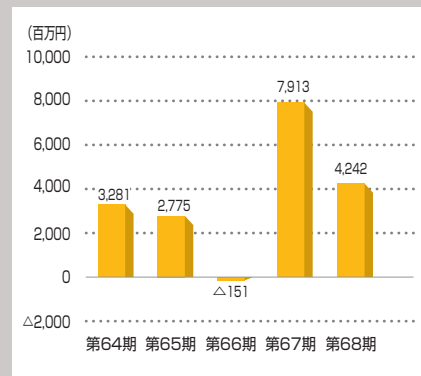
半導体メーカーによる旺盛な設備投資に支えられて、特に装置はメモリや素材ウェーハ向けの研削装置が大幅に増加、ツールも引き続き好調だったため、前年同期比25.1%増加して861億60百万円となりました。

### 当期純利益



前年同期から27億5百万円増加して109億36百万円となりました。対売上高純利益率は、前年同期比0.8%増加の12.7%となりました。

### フリーキャッシュ・フロー



営業活動の結果得られた資金は増加しましたが、本社・R&Dセンター拡張工事など投資活動の結果使用した資金も増加したため、前年同期比36億70百万円減少して42億42百万円となりました。

# Financial Statements

## 連結財務諸表(要旨)

### 連結株主資本等変動計算書

第68期期末(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位:百万円)

科目	株主資本					評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成18年3月31日 残高	13,412	14,494	41,899	△39	69,767	303	205	509	-	424	70,701
当連結会計年度中の変動額											
新株の発行	1,072	1,072			2,145						2,145
剰余金の配当(注)			△1,174		△1,174						△1,174
剰余金の配当			△1,018		△1,018						△1,018
役員賞与(注)			△90		△90						△90
当期純利益			10,936		10,936						10,936
自己株式の取得				△14	△14						△14
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)						△244	490	246	65	26	338
連結会計年度中の変動額合計	1,072	1,072	8,653	△14	10,784	△244	490	246	65	26	11,122
平成19年3月31日 残高	14,485	15,567	50,553	△53	80,551	59	696	755	65	450	81,823

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

2006年5月1日施行の会社法に伴い、「連結株主資本等変動計算書」が新設されました。これは、P9の「連結貸借対照表」で新設された「純資産の部」の中で、主に株主の皆様へ帰属する株主資本等について、その1会計期間における変動事由と変動額をご報告するために作成する計算書類です。



### 株主・投資家情報ページをリニューアルしました。

より充実した情報開示と使いやすさの向上を図るため、2007年4月より、当社ホームページのIRサイトを刷新しました。ディスクをわかりやすく説明した「ディスクについて」のページの新設、コーポレートガバナンスや株主還元方針に関する情報などの掲載をしています。また、ニュースメール配信サービスも開始しました。皆様のアクセス登録をお待ちしています。

〈株主・投資家情報〉ページ



<http://www.disco.co.jp/>

# Questionnaire Result

## 株主アンケート結果

「第68期中間 事業のご報告」にて実施したアンケートにご協力いただき、誠にありがとうございました。2,000件を超すご回答をいただき、回答率は15.4%となりました。たいへん多くの株主の皆様にご協力いただき、貴重なご意見を賜うることができました。ここにアンケートに寄せられたご質問の中から、以下2問について回答いたします。

Q

**海外での事業展開について教えてください。**

A

当社は、主要販売子会社として、米国（カリフォルニア・シリコンバレー）、欧州（ドイツ・ミュンヘン）、中国（上海）、シンガポールの4拠点をしています。最近、日本・米国・欧州の多国籍企業が生産拠点をアジアにシフトする動きがあります。そのためディスコでは、各拠点でお客様の当社への製品販売を行っておりますが、特に欧米の拠点では研究開発・マーケティングに関する情報交換とサービスの提供、アジアの拠点ではお客様の生産拠点への生産・技術に関する情報交換とサービスの提供を行っています。さらに、各拠点のお客様担当と本社の海外営業部が密接に連絡を取り合って情報を一元化し、ディスコグループとしてお客様満足の追求ができる体制を整えております。

Q

**人材不足が社会問題となっていますが、技術の伝承についてはどのような施策をとられていますか？**

A

当社では団塊世代の社員は多くないため、2007年に特に退職者が増える予定はありません。しかしながら、高齢者の活用は重要な課題と捉え、再雇用制度を2006年より実施しております。ベテラン社員の幅広い知識や経験は、次世代への技術の継承や次期幹部社員の育成、若手社員へのアドバイザーとして欠かすことのできない戦力と考えております。ものづくりの技術の伝承という点からも、新規、中途採用に加え、再雇用制度を最大限に活用、充実させていきたいと考えております。

**紙面の関係上一部のご質問にしか回答できず申し訳ございません。**

当社ホームページに、その他の結果について掲載しております。ぜひご覧下さい。

(<http://www.disco.co.jp/answer>)

今後も、株主の皆様のご意見を経営に活かしていきたいと考えておりますので、アンケートへのご意見、ご協力のほど、何卒よろしくお願いいたします。

# DISCO Information

## 会社情報および株式の状況

### ■ 会社概要

本社所在地	東京都大田区大森北二丁目13番11号	
創業年月日	1937年5月5日	
設立年月日	1940年3月2日	
資本金	14,485百万円 (2007年3月末日現在)	
従業員数	1,319名 (2007年3月末日現在)	
主な事業内容	精密加工装置 → 製造および販売 → メンテナンスサービス → オペレーションやメンテナンスの研修サービス → 解体リサイクル事業 → リースおよび中古品販売 精密加工ツール → 製造および販売 精密部品の有償加工サービス	
事業所	本社・R&Dセンター 広島事業所(呉工場、桑畑工場、長谷工場)	
国内拠点	仙台支店、大阪支店、九州支店 諏訪営業所、名古屋営業所	

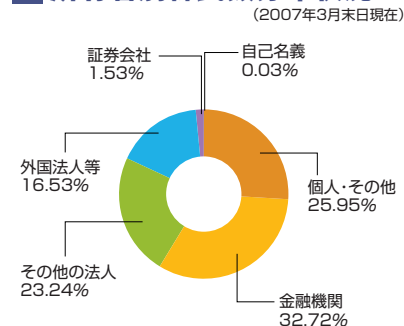
### ■ ディスコグループ関連会社

国内法人	株式会社テクニスコ 株式会社ディスコ アプレイシブ システムズ 株式会社ディーエスティー 株式会社ディーエスティー九州 株式会社ダイイチコンポーネッツ
海外法人	DISCO HI-TEC AMERICA, INC. DISCO HI-TEC EUROPE GmbH DISCO HI-TEC FRANCE SARL DISCO HI-TEC U.K. LTD. DISCO HI-TEC MOROCCO SARL DISCO HI-TEC (SINGAPORE) PTE LTD DISCO HI-TEC (MALAYSIA) SDN. BHD. DISCO HI-TEC (THAILAND) CO., LTD. DISCO TECHNOLOGY (SHANGHAI) CO., LTD. JETSIS INTERNATIONAL PTE LTD DD Diamond Corporation DISCO-SEA AMERICA, INC. TECNISCO (SuZhou) Co., Ltd DHK Solution Corporation

### ■ 役員 (2007年6月22日現在)

名誉会長	関家 憲一
(取締役・監査役)	
代表取締役社長	溝呂木 斉
常務取締役	関家 圭三 関家 一馬
取締役	関家 英之 梶山 啓一 溝呂木 隆夫 田村 隆夫
常勤監査役	玉利 晋 高柳 忠雄
監査役	浅海 芳久 黒沼 忠彦 荒井 一尚 吉永 晃
(執行役員)	

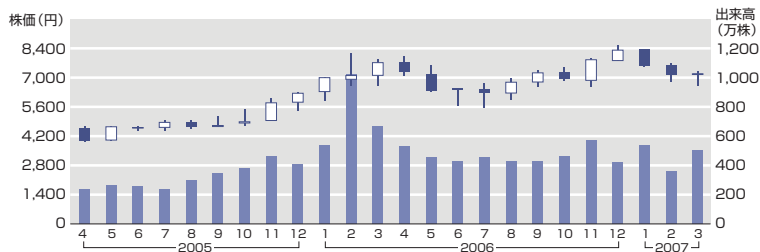
### ■ 所有者別株式数分布状況 (2007年3月末日現在)



### ■ 株式概要 (2007年3月末日現在)

上場証券取引所	東京証券取引所第一部上場(証券コード6146)	
発行済株式総数	33,982,518株	
株主数	13,598名	
大株主	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 : 4,160千株 / 12.24% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 : 2,928千株 / 8.62% 株式会社ダイイチ企業 : 1,998千株 / 5.88% 株式会社ダイイチホールディングス : 1,998千株 / 5.88% 株式会社OCTAGON LAB : 1,704千株 / 5.01% 関家 臣二 : 1,348千株 / 3.97% 関家 憲一 : 1,030千株 / 3.03% 資産管理サービス信託銀行株式会社 : 1,029千株 / 3.03% 株式会社オレンジコーラル : 846千株 / 2.49% 日本生命保険相互会社 : 770千株 / 2.27%	

### ■ 株式チャート



# DISCO Story..... 4

〈1992年～1993年〉

【全6回シリーズ】

## 社運を賭けた奇跡が起きるまで “Xプロジェクト” を実行せよ

1991年、業績は好調ながら、少しずつ暗い影がディスコを覆っていました。営業本部長の溝呂木齊常務（当時、現社長）はダイサ（精密切断装置）の製品競争力がなくじりじりとシェアが低下している、と営業の最前線で感じていました。そして、もう一人、社長の甥である関家一馬はソフトエンジニアとしてダイサ用画像処理装置の開発をしながらも、「自社のダイサは他社機に比べ競争力が無い」と強い危機感を持ち、ニーズに合った装置開発を提案するため、溝呂木に直談判を行いました。

そして、1992年1月1日に辞令が発表されます。『Xプロジェクト』プロジェクトの目的は「年末のセミコンジャパン92で発表できるよう新機種開発を行うこと。」入社3年目の関家をリーダーに、平均年齢25歳のプロジェクトメンバーが専任で装置開発を行うことになったのです。

この年、シリコンサイクルの不況期も重なり、会社はリストラ策を断行しました。管理職以上の賃金カット、残業規制、早期退職制の導入、そして新規事業である縦型拡散炉事業からの撤退。1992年度は、創業以来2度目の赤字決算となりました。そんな中、Xプロジェクトのメンバーは高いモチベーションを持ち一体となって、目の前の仕事に集中して取り組みます。

プロジェクトでは、これまでにはない徹底した小型化と低コスト化が追求されました。既存のセミオートダイサの幅は850mmでしたが、DAD320は業界最小の横幅500mmに抑えられました。また、ダイサのあるべき姿を徹底的に考えるこ



セミコンジャパン1992の  
DISCOのブース



DAD320

とによって、あらゆる部位の設計を根本的に見直し、基本性能を向上しつつ部品点数の大幅削減を実現しました。さらにそれまであまり行われてこなかった機種間の部品の共通化を進めました。プロジェクトメンバーは、連日連夜2時3時、土日返上で奮闘し、3割以上のコストダウンに成功しました。

12月2日。フルオートダイサDFD620/DFD640、そして10台のセミオートダイサDAD320がずらりと並びセミコンのブースを飾りました。若いチームは一年間という短期間で画期的な装置開発を成し遂げたのです。

その後、市場投入された新製品は顧客のニーズに合致し、1993年度の業績は黒字に転換。Xプロジェクトは、その後も複数の装置を生み出しただけでなく、開発期間・コストなどを含め、ディスコにおけるそれまでの仕事のやり方を大きく変えることになったのです。この成功体験は社内に語り継がれ、その後のディスコの成長の上で大きな転換点となりました。

## 株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
期末配当金 受領株主確定日	毎年3月31日
中間配当金 受領株主確定日	毎年9月30日
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日とします。 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めます。
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
同事務取扱場所 (同送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL 0120-232-711 (フリーダイヤル)
同取次所	三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 野村證券株式会社 全国本支店
公告方法	電子公告（当社のホームページに掲載します） ただしやむを得ない事由により電子公告ができないときは 日本経済新聞に掲載します。
証券コード	6146

## “Cutting Edge” とは...

Cutting Edgeとは、辞書で引くと「刃の先端」という意味のほか、「最先端」という意味があります。ディスコグループの「高度な Kiru・Kezuru・Migaku技術によって遠い科学を身近な快適につなぐ」という企業ミッションをより深くご理解いただくために、常に最先端の技術を保有しながらも、社会に積極的に貢献していきたいという願いをこのタイトルに込めました。

これからも、ディスコグループの最先端の技術情報とともに、報告内容を充実してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

**DISCO**

Kiru・Kezuru・Migaku Technologies



株式会社 **ディスコ**

143-8580 東京都大田区大森北 2-13-11  
<http://www.disco.co.jp/>

**re100**

古紙リサイクル配合率100%再生紙を  
使用しております。



環境に優しい植物性大豆油インキを  
使用しております。